

证券代码：688486

证券简称：龙迅股份

公告编号：2025-038

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 重要内容提示：

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“龙迅股份”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心，对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于2025年2月28日在上海证券交易所网站披露了《龙迅股份关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（以下简称“行动方案”），自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。公司于2025年8月22日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》，现将“2025年上半年行动方案主要举措的落实及成效”报告如下：

一、聚焦经营主业，促进高质量发展

2025年上半年，全球半导体芯片市场在AI技术普及与场景创新的双重驱动下呈现结构性增长，公司持续聚焦显示器/商显及配件、工业及通讯类产品线的技术升级业务，重点布局智能驾驶与智慧座舱、端侧设备、高性能传输等重点产品线。力求用高品质、高性能的产品，精准、快速地响应各领域客户需求，持续加强全球业务拓展及品牌影响力。报告期内，公司实现营业总收入24,697.58万元，较上年同期增长11.35%；归属于母公司所有者的净利润7,152.05万元，较上年同期增长15.16%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,689.77万元，较上年同期增长

17.10%。公司持续优化产品竞争力，2025年上半年毛利率为54.88%。

报告期内公司股份支付费用为663.37万元，剔除股份支付和所得税影响后，归属于母公司所有者的净利润为7,807.08万元，较上年同期增长15.68%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,344.81万元，较上年同期增长17.56%。

截至2025年6月底，公司总资产为153,969.57万元；归属于上市公司股东的净资产为146,108.22万元。

（一）持续研发创新，强化核心竞争力

公司充分发挥自身在高速数据传输、视频处理器及显示驱动技术的长期积累，持续加大技术创新，提升现有产品性能的同时，精准把握行业技术演进与市场需求变化的趋势，重点布局AI技术普及与场景创新带来的行业增长。2025年上半年，公司继续加大研发投入，进一步提升研发平台硬件设施水平，壮大研发团队，优化研发体系，产品研发速度显著提升，报告期内累计投入5,706.07万元，较上年同期增加22.87%，占营业收入比重为23.10%。

公司不断扩展和完善高清视频桥接及处理芯片产品线，融合AI技术普及对末端算力需求的爆发预测，通过持续的技术攻关和设计优化，芯片的面积和功耗得到有效降低，产品性能持续升级，市场竞争力持续增强，巩固了公司在相关领域的领先地位。报告期内，公司成功研发出主要应用于商显和安防领域的支持多输入混合信号切换的芯片，该芯片支持高刷新率和可变刷新率，最高单通道速率可达12Gbps，能够单芯片解决四个输入接口的混合信号切换的点屏与环出问题，大幅降低了终端产品的设计复杂度和生产成本，为该领域客户的产品升级提供了有力支撑。公司还升级了应用于端侧AI领域的低功耗、低延迟视频桥接芯片，相较于上一代产品，新品通过优化设计结构和更新工艺，在性能上实现跃升，功耗进一步降低，兼容性也得到显著提升，更加有利于为AI模型的训练提供实时要素。这些新产品将为客户提供更加优质和多样化的选择，几款产品预计于下半年陆续投放市场并实现批量出货。

公司利用在数模混合信号领域的技术积累，积极研发面向AI&边缘计算、先进通讯等领域的高速数据传输芯片。报告期内，公司在DP2.1、USB、PCIe、SATA等协议的研究开发上持续发力，并取得了阶段性进展，部分项目已进入流片阶段。产品具

有高速率、高可靠性、低延迟和低误码率等特征，产品参与AI训练、推理运算的数据传输和储存，是提升AI系统性能的关键器件，在超算、AI智能、数据中心、消费电子等领域有着非常广阔的市场空间。

汽车电子作为公司重要的业务拓展方向，公司持续加大在该领域的研发投入和新品布局。公司的桥接芯片在智能驾驶和智慧座舱持续保持市场优势。2025年上半年，公司叠加在汽车电子和端侧AI领域的技术优势和客户积累，扩展了车载端侧AI的应用场景；智慧座舱方面，从适配单一座舱平台进一步扩展到多平台适配，覆盖的车型和客户持续增加。针对汽车市场对于视频长距离传输和超高清视频显示需求开发的车载SerDes芯片组目前处于全面市场推广阶段，公司把握新兴市场发展机遇，已将SerDes芯片组拓展进入eBike、摄像云台、无人机等新业务领域。为提升车载产品管控等级及整体管理水平，公司积极推进汽车体系建设和产品认证，报告期内，新增一个产品通过汽车软件过程改进与能力评定ASPICE level2评估认证，新增2个产品通过AEC-Q100 Grade2认证测试。截至报告期末，公司共有11颗桥接类的芯片通过了AEC-Q100测试认证，其中5颗产品通过Grade 2认证。

报告期内，公司进一步升级研发平台硬件设施，引入先进的验证平台和仿真测试设备，显著提升了研发效率与成果转化速度；不断优化研发管理体系，通过建立更高效的项目协作和IP复用机制，使得产品研发周期大幅缩短。上半年公司新增知识产权申请26项，截至2025年6月30日，公司已获得境内专利114项（其中发明专利为92项），境外专利44项（全部为发明专利），集成电路布图设计专有权136项，软件著作权143项。

（二）重视人才发展战略，优化激励科研团队

公司高度重视人才发展战略，在人才梯队建设方面，通过精准引进行业高端技术人才加内部培养相结合的方式，研发团队规模稳步壮大，专业结构更趋合理，为技术攻关提供了坚实的人才支撑。2025年上半年，公司有针对性地围绕AI芯片架构和算法方向推进人才储备，截至2025年6月30日，公司研发人员177人，占员工总人数的72.84%，研发人员中硕士及以上学历占54.24%。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员

工的积极性，在充分保障股东利益的前提下，公司制定并实施了《2024年限制性股票激励计划》。2025年1月，公司向100名激励对象预留授予21.9780万股第二类限制性股票；2025年5月到6月期间，公司完成了“2024年限制性股票激励计划”第一个归属期归属登记工作，本次归属股票的上市流通数量为623,443股。股权激励计划的顺利实施，有助于增强团队稳定性，激发员工积极性与创造力，为公司在技术创新、市场拓展等方面提供坚实的人力支撑，助力公司达成战略目标，实现可持续发展。

（三）优化供应链管理，提升工艺水平

公司持续优化供应链系统，完善现有的供应商选择和管理流程，强化与供应商更为紧密的合作关系，从而提升公司产品质量和交付能力；为打造国内国外代工双循环供应体系，确保供应链的稳定性和安全性，报告期内，公司进一步扩充产能，新增晶圆厂2家，封装厂1家。新工艺方面，公司加大了对新工艺、新材料、新封装形式的研究与应用，力求通过采用新的半导体技术和先进的制造工艺，开拓更高规格的产品，使得产品在数据传输速度、功耗管理等方面获得更为卓越的表现。目前公司在28nm、22nm的工艺上已展开多项数模混合芯片的研发工作，产品最高传输速率可达20Gbps，此举标志着公司工艺迭代升级又迈上一个台阶。

（四）推进募投项目建设，增强公司发展保障

2023年2月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人民币10.30亿元，主要用于“高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目”、“高速信号传输芯片开发和产业化项目”、“研发中心升级项目”和“发展与科技储备资金”。

根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外环境等因素，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司于2025年2月27日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体前提下，同意公司对募集资金投资项目“高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目”、“高速信号传输芯片开发和产业化项目”达到预定可使用状态日期进行延期。截至2025年6月30日，已使用募集资金28,432.36万元。募集资金投资项目的推进和阶段兑现，有效促进了公司研发能力提升、产品市场竞争力提高以及主营业务的发展，

增强了公司整体可持续发展能力。

二、重视股东回报，分享公司价值成长红利

公司高度重视股东的投资回报，努力以良好的业绩成长回馈投资者，为股东创造长期可持续的价值。上市以来，公司积极实施现金分红、资本公积转增等举措，以提升投资者回报、增强投资者信心，促进公司内在价值与市场价值共同增长。

2025年上半年，公司实施完成了2024年年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），合计派发现金红利70,989,181.20元（含税），本年度公司现金分红金额占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为49.16%；同时，以资本公积向全体股东每10股转增3股，不送红股，合计转增30,423,935股，转增后公司总股本由102,280,590股增加至132,704,525股。

三、提升信息披露质量，积极传递公司投资价值

公司积极履行各项信息披露义务，持续提升公司信息披露的质量和透明度。2025年上半年，公司累计发布定期报告2份，临时公告33份。公司坚持从投资者需求出发，持续优化定期报告编制披露方式，从框架、内容、形式等多方面进行拓展，以更简明清晰、通俗易懂的方式展现公司主营业务发展及经营情况。2025年上半年，公司举办了2024年年度和2025年第一季度业绩说明会，结合文字互动、图文展示等形式，全方位向投资者展示公司经营情况。报告期内，组织参与投资者线上线下路演交流活动21场，披露投资者关系活动记录表8份；公司通过e互动平台积极与投资者交流，回复率100%。通过多层次沟通渠道，让投资者全面及时地了解公司的基本情况，让投资者更加充分、全面地了解公司的内核价值与发展战略，积极传达公司的投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

四、持续完善公司治理，强化“关键少数”责任

报告期内，公司进一步完善内部治理，提高公司的经营管理水平和风险防范能力。2025年4月，为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，

及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司特制定了《舆情管理制度》，并颁布实施。

公司高度重视董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制。报告期内，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构组织的线上线下培训23人次，及时通过邮件向全体董监高传递监管动态，确保监管精神理解准确、执行有效，着力提高“关键少数”的专业素养和履职能力，强化“关键少数”人员合规意识。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度，做好内幕信息保密工作，通过多维度提升公司治理能力切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

五、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

2025年下半年，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，专注主营业务，推进新产品战略布局，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理积极回报广大投资者，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2025年8月23日